

半導體工程系 碩士在職專班 113 學年度入學課程結構規劃表

課程類別			一年級						二年級					
			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期		
			課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數
必修	應修課程數 5 門/ 應修學分數 14 學分	微電子工程科技	3	3	工程科技專論	3	3	論文	6	6	論文	6	6	
		專題研究(一)	1	1	專題研究(二)	1	1							
專業課程	應修學分數 至少 16 學分	光電工程/3/3 奈米材料/3/3 太陽能工程/3/3 高等微機電工程/3/3 半導體感測元件/3/3 高等半導體元件/3/3 高等積體電路製程/3/3 光電元件量測與分析/3/3 高等發光二極體製造技術及應用/3/3		高等真空技術/3/3 電源系統設計/3/3 發光二極體專論/3/3 數位積體電路設計/3/3 高等太陽能光電工程/3/3 嵌入式系統設計與實務/3/3 射頻與微波電路設計/3/3 半導體元件設計與模擬/3/3										

備註：

- 一、畢業總學分數為 30 學分。
- 二、必修 14 學分，選修 16 學分。
- 三、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。
- 四、系所訂定條件（學程、檢定、證照、承認外系學分及其他）：論文，請擇一學期修讀，修畢且及格者方可畢業。



113. 6. 06